

# TDES4940 4K V<sup>3</sup>Link 增强视频转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器

## 1 特性

- DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 发送器
  - VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器
  - HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
  - 主链路：1、2 或 4 通道
  - 每通道高达 8.1Gbps
  - 辅助通道 1Mbps
  - 热插拔检测 (HPD)
  - 将聚合视频流提取到本地 eDP 显示
  - 专为 60Hz 时 4K 视频分辨率而设计
  - 流同步和分离
- V<sup>3</sup>Link 增强视频接口
  - 每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps；双通道高达 27Gbps
  - 同轴/STP 互连支持
  - 可选 1 通道、2 通道
  - 菊花链和分离
  - 自适应均衡
- 超低延时控制通道
  - 两个高达 1MHz 快速+ 模式 I2C (本地总线访问高达 3.4MHz)
  - 高速 GPIO
  - 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
- 兼容性
  - 具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
  - V<sup>3</sup>Link 视频和 V<sup>3</sup>Link 增强视频产品系列
- 图像增强功能 (白平衡和抖动)
- 安全和诊断
  - 电压和温度监测
  - BIST 和图形生成
  - CRC 和错误诊断
  - 控制位上的 ECC
  - 用于防伪认证的唯一 ID
- 高级链路稳定性和 EMC 控制
  - 展频时钟生成 (SSCG)
  - 自适应接收器均衡 (AEQ)

- 低功耗操作
  - 1.8V 和 1.15V 双电源供电
- 资格认证
  - 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  - 温度：-20°C 至 +85°C

## 2 应用

- 高分辨率显示：
  - 手术室显示器
  - 座椅靠背娱乐显示
  - 高分辨率 HMI

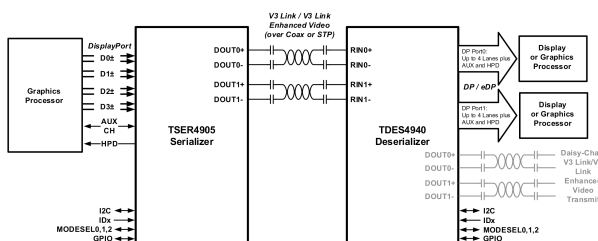
## 3 说明

TDES4940 是一款 V<sup>3</sup>Link 增强型视频转 DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器件。该芯片组与 V<sup>3</sup>Link 增强型视频串行器配合使用，可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆提供高速串行化接口。TDES4940 是一款 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 兼容器件，支持 HBR3 和 SuperFrame 格式等高级功能。该器件支持 4K 30 位颜色及更高的视频分辨率。V<sup>3</sup>Link 增强视频支持视频和音频数据传输以及全双工控制，包括同一链路上的 I2C 和 GPIO 数据。视频数据的整合和对 V<sup>3</sup>Link 增强视频通道的控制减少了互连尺寸和重量，并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在兼容的 V<sup>3</sup>Link 模式下，该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深，并且在与支持 HDCP 的串行器配对时支持 HDCP v1.4。

### 器件信息

器件型号	封装 (1)	封装尺寸 (标称值)
TDES4940	VQFN (88)	12mm × 12mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



## 4 器件和文档支持

### 4.1 文档支持

#### 4.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- [焊接规格应用报告](#)，[SNOA549](#)
- [IC 封装热指标应用报告](#)，[SPRA953](#)
- [无引线框架封装 \(LLP\) 应用报告](#)，[SNOA401](#)

### 4.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

### 4.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 4.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 4.5 术语表

#### TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 5 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## 5.1 封装选项附录

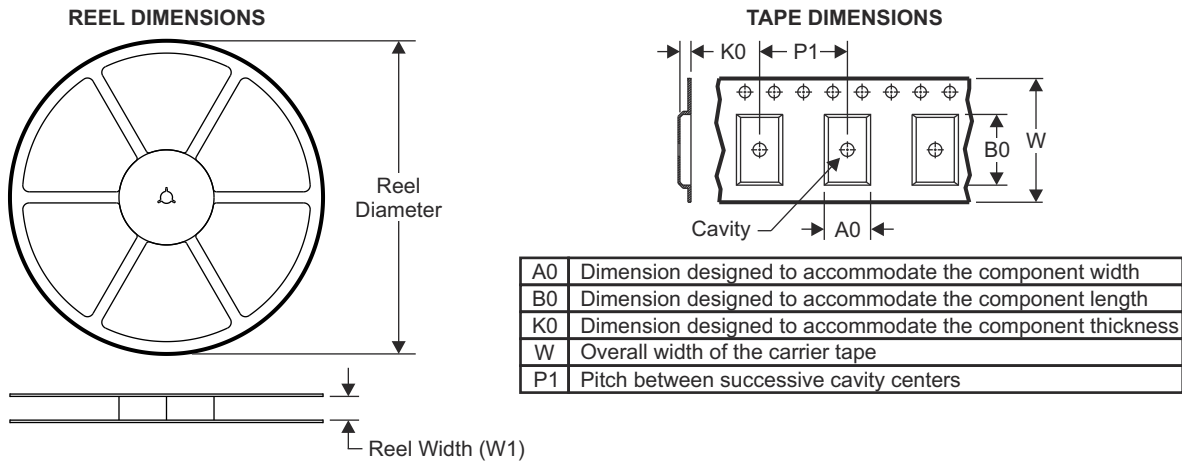
### 封装信息

可订购器件	状态	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划	铅/焊球镀层	MSL 峰值温度	工作温度 (°C)	器件标识
TDES4940RURQT1	ACTIVE	VQFN	RUR0088D	88	250	RoHS 和绿色环保	NiPdAuAg	Level-3-260C-168 HR	-20 至 85	TDES4940
TDES4940RURRQ1	ACTIVE	VQFN	RUR0088D	88	2500	RoHS 和绿色环保	NiPdAuAg	Level-3-260C-168 HR	-20 至 85	TDES4940

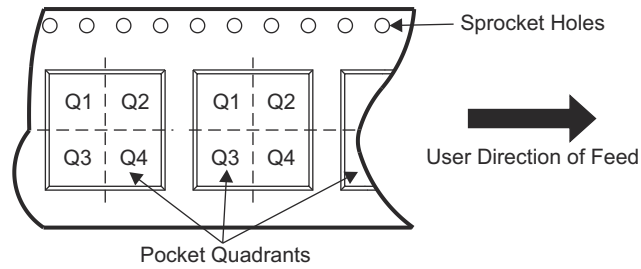
**重要信息和免责声明：**本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其它受限制的信息。

在任何情况下，TI 对由此类信息产生的责任决不超过本文档中发布的 TI 每年销售给客户的 TI 器件总购买价。

## 5.2 卷带封装信息

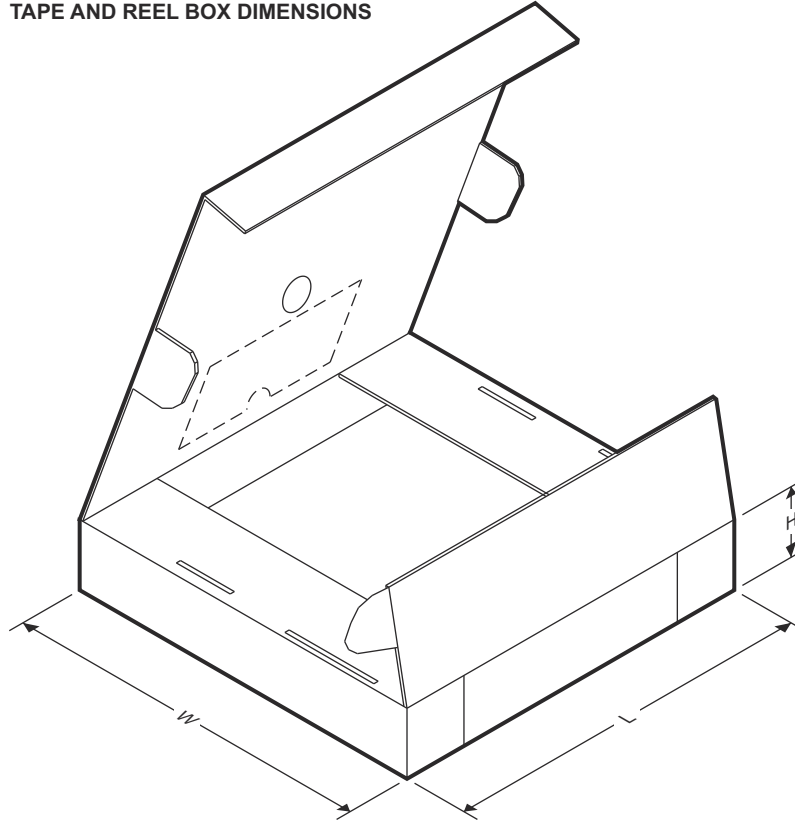


### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

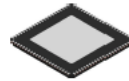


器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TDES4940RURQ1	VQFN	RUR0088 D	88	250	180	24.4	12.30	12.30	1.10	16.00	24.00	Q2
TDES4940RURRQ1	VQFN	RUR0088 D	88	2500	330	24.4	12.30	12.30	1.10	16.00	24.00	Q2

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
TDES4940RURRTQ1	VQFN	RUR0088D	88	250	210	185	35
TDES4940RURRQ1	VQFN	RUR0088D	88	2500	360	360	36
TDES4940RURRQ1	VQFN	RUR0088D	88	2500	367	367	35

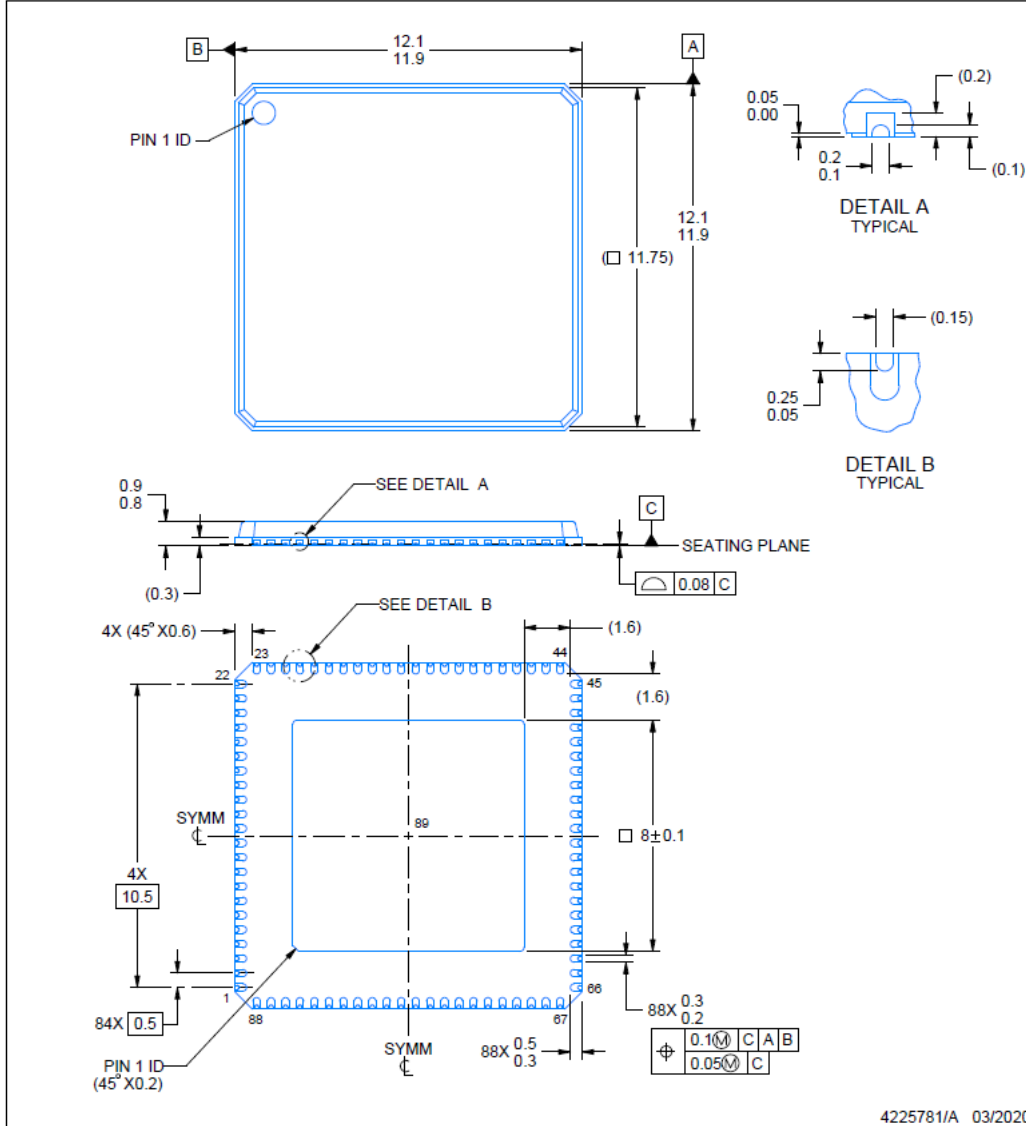


**RUR0088D**

**PACKAGE OUTLINE**

**VQFN - 0.9 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



**NOTES:**

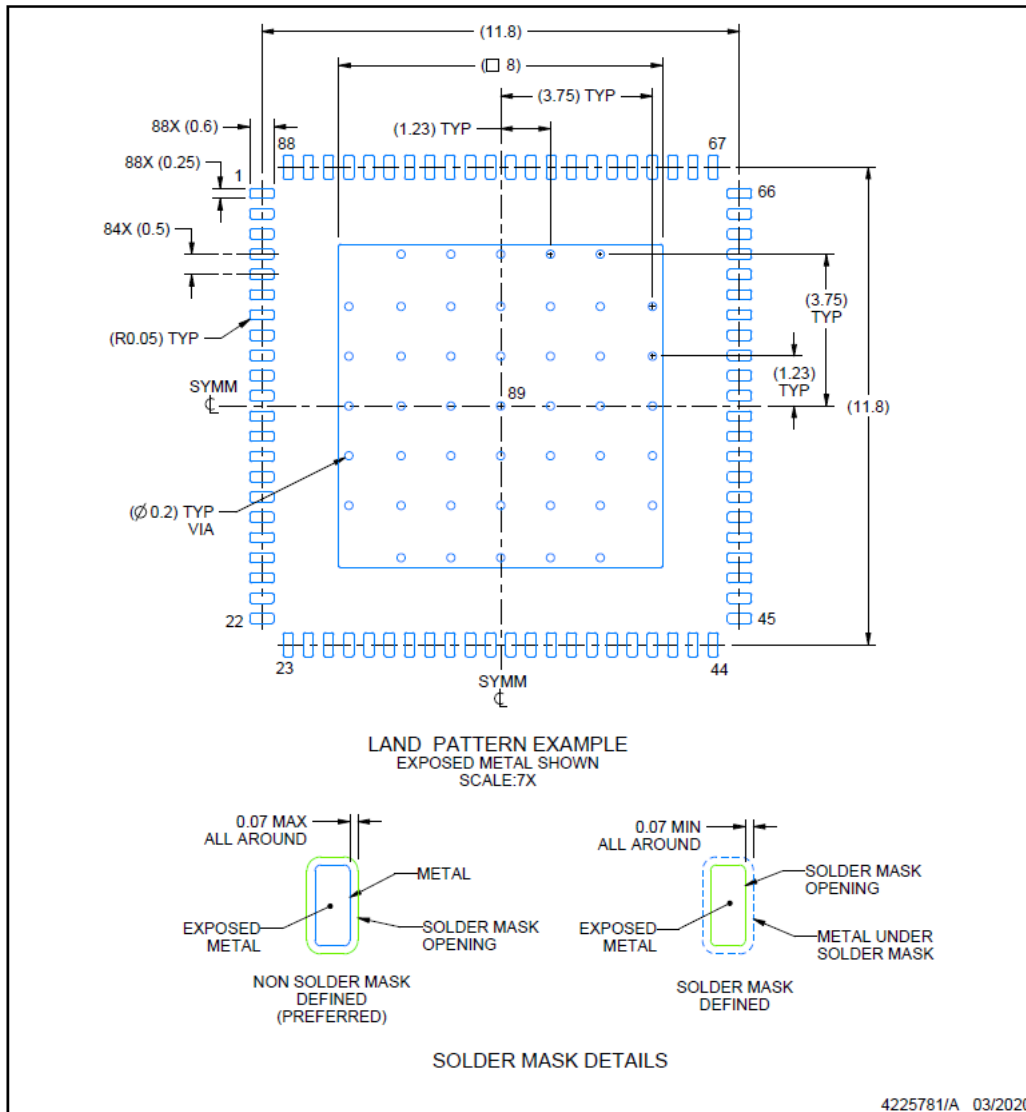
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

## EXAMPLE BOARD LAYOUT

RUR0088D

VQFN - 0.9 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

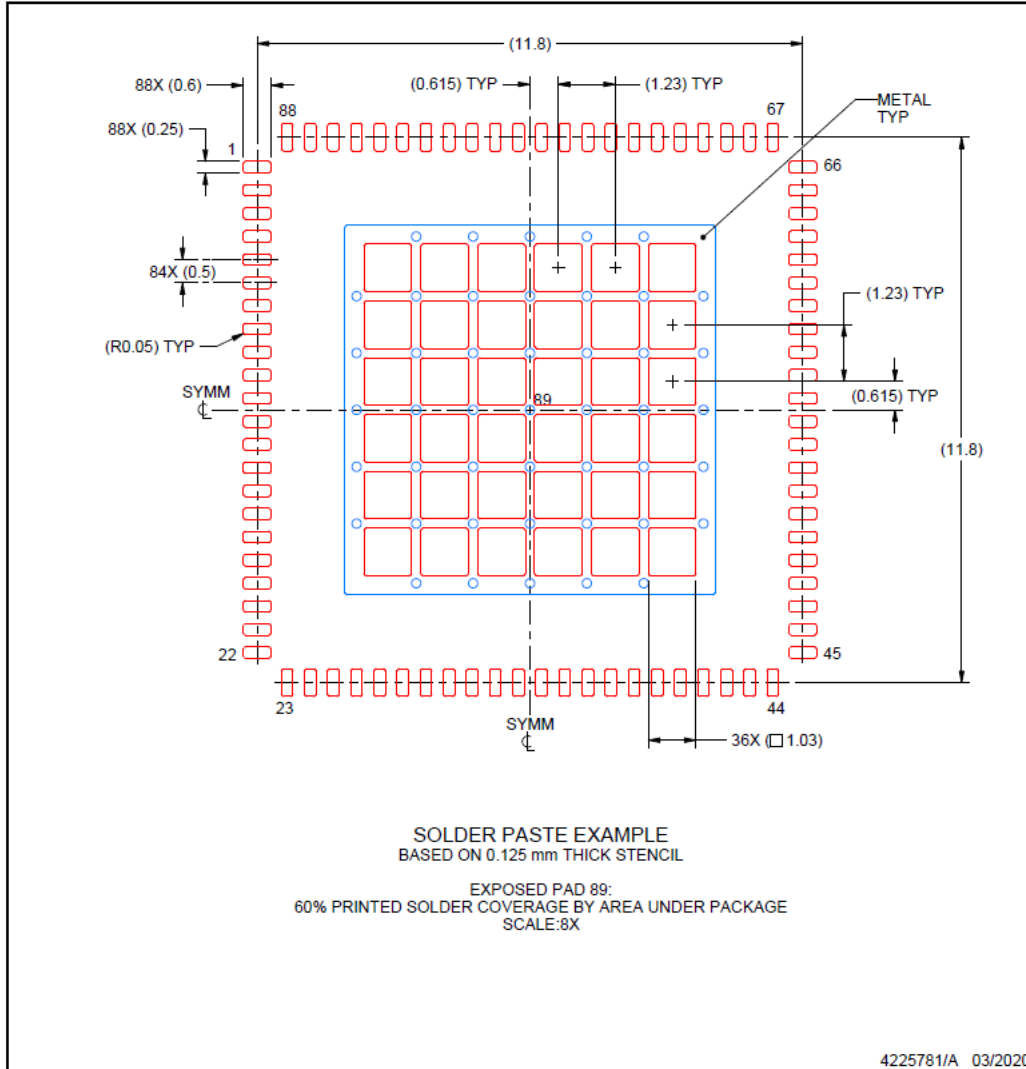


## EXAMPLE STENCIL DESIGN

**RUR0088D**

**VQFN - 0.9 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TDES4940RURR	ACTIVE	VQFNP	RUR	88	2500	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-20 to 85	TDES4940	<a href="#">Samples</a>
TDES4940RURT	ACTIVE	VQFNP	RUR	88	250	RoHS & Green	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-20 to 85	TDES4940	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBsolete:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TDES4940RURR	VQFNP	RUR	88	2500	330.0	24.4	12.3	12.3	1.1	16.0	24.0	Q2
TDES4940RURT	VQFNP	RUR	88	250	180.0	24.4	12.3	12.3	1.1	16.0	24.0	Q2

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TDES4940RURR	VQFNP	RUR	88	2500	367.0	367.0	35.0
TDES4940RURT	VQFNP	RUR	88	250	210.0	185.0	35.0

## GENERIC PACKAGE VIEW

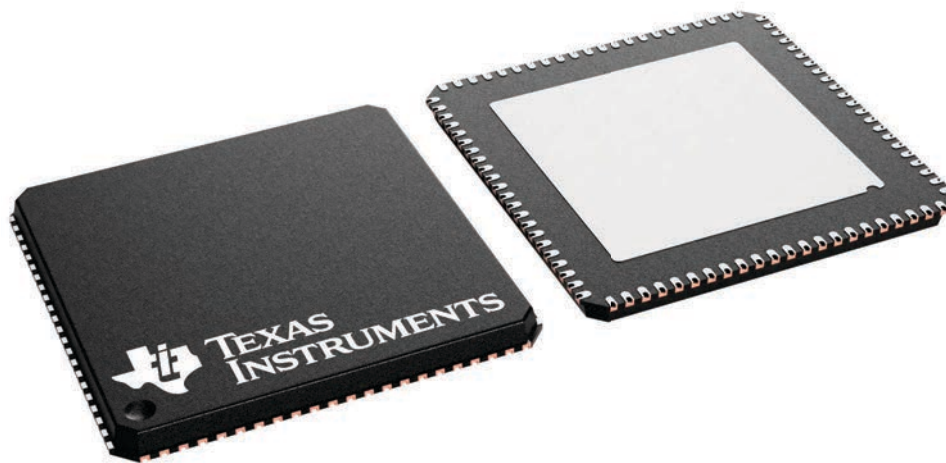
**RUR 88**

**VQFN - 0.9 mm max height**

12 x 12, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4228969/A

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司